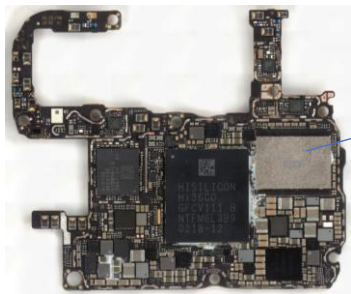


## 3D NAND フラッシュメモリ：YMTC (HUAWEI Pura X搭載) 構造解析レポート



HUAWEI Pura X搭載基板



3D NAND パッケージ

### レポート背景と概要

YMTC（長江存儲科技）は、中国政府の強力な支援を受ける中国最大の3D NANDフラッシュメーカーです。独自の積層技術「Xtacking」を武器に驚異的なスピードでシェアを拡大し、世界市場で、Samsung、SK hynix、キオクシアに次ぐ第4位に躍進しています。

YMTCの3D NANDフラッシュメモリは、Huawei、Xiaomi、VivoやOPPOなど、中国ブランドの端末において多く採用が進んでいます。

今回、2025年3月に発売されたHUAWEI Pura X搭載のYMTC社 3D NANDフラッシュメモリの構造解析レポートをリリースします。

### 製品特徴

HUAWEI Pura X搭載 3D NAND フラッシュメモリ 製品リリース日(Pura X)：2025年3月

Xtackingアーキテクチャ採用

YMTC独自の周辺回路（CMOS）とメモリセルを別々のウェハで製造し、ハイブリッドボンディング技術で接合。

### 解析内容&レポート価格

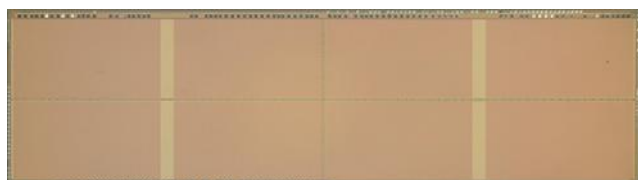
**構造解析レポート 価格：¥800,000（税別） 発注後1weekで納品**

- ・1PKG内にフラッシュメモリチップは、4チップ搭載（2チップ積層×2）され、インターフェースICチップも搭載されている。
- ・メモリセル部断面解析（WL, BL方向）を行い、構造確認とXtackingの世代、メモリゲート積層数の確認、配線ピッチからのプロセス推定を行っています。
- ・平面解析では、メモリセル、チップ裏面側からの観察を行っています。

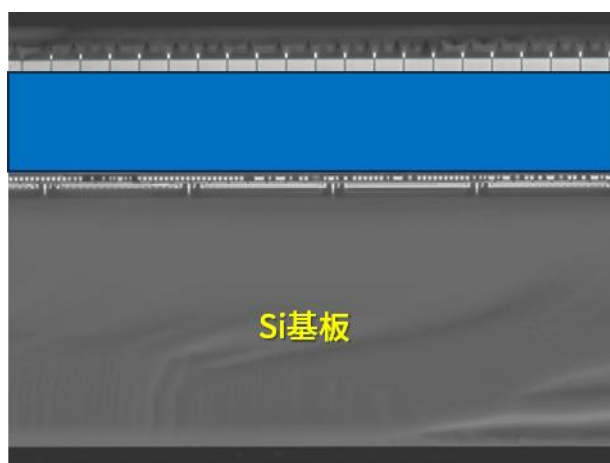
## 構造解析レポート目次

	Page
1. デバイスサマリー . . . .	3
2. 製品分解 . . . .	4
3. パッケージ観察 . . . .	5
4. X線観察 . . . .	6
5. チップ観察 . . . .	8
6. 断面構造解析 . . . .	11
7. チップ裏面観察 . . . .	32
8. 平面SEM観察 . . . .	39
9. 解析まとめ . . . .	41

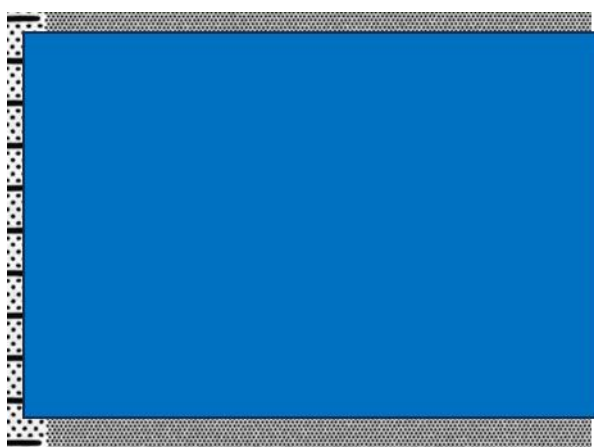
## 構造解析レポートからの抜粋



3D NANDチップ写真



メモリセルの断面SEM像



メモリセルの平面SEM像